

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成19年11月22日(2007.11.22)

【公開番号】特開2001-172090(P2001-172090A)

【公開日】平成13年6月26日(2001.6.26)

【出願番号】特願2000-309392(P2000-309392)

【国際特許分類】

C 04 B 38/00 (2006.01)
C 04 B 41/85 (2006.01)
C 04 B 35/00 (2006.01)

【F I】

| | | |
|--------|-------|---------|
| C 04 B | 38/00 | 3 0 3 Z |
| C 04 B | 41/85 | C |
| C 04 B | 35/00 | H |

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月10日(2007.10.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】平均径が5μm以下の独立した気孔を有するセラミックスであって、(1)該気孔の気孔率が7%以下であり、(2)比剛性(ヤング率(GPa)/密度(g/cm³))が30以上であり、(3)JIS R1618による、20~30における熱膨張係数の絶対値が3×10⁻⁷/K以下であるセラミックス。

【請求項2】JIS R1602によるヤング率が100GPa以上である請求項1記載のセラミックス。

【請求項3】スポジューメン、ユーフリップタイト、リン酸ジルコニル又はチタン酸アルミニウムを主成分とし、窒化ケイ素、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素ウイスラー、酸化錫、炭素、及びチタン酸鉄からなる群から選ばれる少なくとも1種を副成分として含み、該副成分の含有量が1~44重量%であるセラミックス。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載のセラミックスを基材に使用してなる半導体製造装置用部材。

【請求項5】前記基材の表面に導電性被膜が形成されてなる請求項4記載の半導体製造装置用部材。

【請求項6】前記導電性被膜が炭化ケイ素、炭化チタン、炭素、窒化チタン及び窒化アルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも1種からなるものである請求項5記載の半導体製造装置用部材。

【請求項7】前記導電性被膜が窒化アルミニウム及び窒化チタンからなるものである請求項6記載の半導体製造装置用部材。